

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△							△				
△							△				
適用規格											
定格	電圧	AC 250V				使用温度範囲	-30℃ ~ +85℃ (注1)				
	電流	AWG22~26 : 2A				保存温度範囲	-10℃ ~ +60℃ (注2)				
		AWG28 : 1A									
		AWG30 : 0.5A									
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ表示	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致すること。				○	○
		目視にて確認する。								○	○
電気的性能	接触抵抗	100mA (DC又は1000Hz) で測定する。				30mΩ以下				○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。				1000MΩ以上				○	—
	耐電圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—
機械的性能	繰り返し動作	50回の抜き差しを行う。				①接触抵抗 : 30mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	耐振性	周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、 加速度 $-m/s^2$ で3方向各2時間試験する。				①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	耐衝撃性	加速度490m/s ² 、持続時間11ms、 正弦半波3方向各3回試験する。				①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度+40±2℃、湿度90~95%の条件で、 96時間放置後、試験する。				①接触抵抗 : 30 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 500MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5~+35 → +85 → +5~+35℃ 時間 30 → 5~15 → 30 → 5~15分 を5サイクル 試験する。				①接触抵抗 : 30 mΩ以下 ②絶縁抵抗 : 1000MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 240℃ 10秒以内 220℃以上 30秒以内 《 予熱部 》 150℃ 100~120秒 リフロー炉に2回通し、常温常湿中に 1時間放置後、試験する。 【 手半田の場合 】 半田ごてで290±10℃、3秒の条件にて 半田付けを行う。 但し、端子に力を入れないこと。				外観の変形及び端子等に 著しいがたがないこと。				○	—
	半田付け性	半田温度 230±5℃、 浸漬時間 3秒間の半田付けを行なう。				半田浸漬面の95%以上が 新しい半田で濡れていること。				○	—
備考						製図	設計	検図	承認	出図	
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。											
(注2) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。											
基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温度範囲を適用。											
試験規格の記載のない試験方法はJIS-C-5402を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品規格表			製品名 DF11C-20DP-2V(57)		
IBCL CL		図番 SLC4-071162-01				製品コード CL543-0690-0-57				1 1	